**证券代码：688047 证券简称：龙芯中科**

**龙芯中科技术股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动√现场参观 □其他  |
| 参与单位名称 | 富国基金、华泰证券 |
| 时间 | 2024年11月13日 |
| 地点 | 北京市海淀区中关村环保科技示范园龙芯产业园2号楼 |
| 上市公司接待人员 | 董事会秘书-李晓钰、证券事务代表-李琳 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **1、龙芯目前毛利率偏低，是否和规模效应有关？后续公司毛利率是否会有提升？**是的，规模效应是一方面原因，当芯片销量不够高的时候，单颗芯片分摊的固定成本会比较高。目前我们看到了电子政务市场需求回暖的迹象，随着政策性市场逐步启动，龙芯芯片销量提升，Q3信息化芯片的毛利率也随之提升。另外，目前批量出货的桥片是之前产能最紧张时生产的，成本较高，改版桥片回来后，会对毛利产生积极的贡献。后续新的服务器芯片出来，在性价比方面，我们认为在充分竞争市场中也比较有优势，随着服务器芯片销量的逐步增加，毛利率也会有提升。工控芯片这边，2024年高质量等级芯片销量减少，这部分业务的对毛利贡献较高，随着相关市场逐渐恢复常态，龙芯高质量等级芯片业务也会逐步恢复，对公司的毛利率将会是正向的影响。因此，随着相关市场逐渐恢复常态，新款产品性价比的提升，芯片销量逐渐恢复，龙芯整体业务的毛利率会有所提升。**2、龙芯显卡的定位，是否有对标的产品？有研发时间表吗？**龙芯GPU的定位首先是与CPU形成自我配套，降低系统成本。目前在研的9A1000定位为入门级显卡以及终端的AI推理加速（32TOP），显卡性能对标AMD RX550，预计2024年底或者春节前代码冻结，争取明年上半年流片。后续计划研制的9A2000性能是9A1000的8-10倍。在此基础上使用更先进工艺，争取9A3000实现跨越发展。**3、龙芯下一代桌面CPU产品工艺不变，请教下在相同的工艺节点上，在工艺、设计优化等方面是否有创新的点来提高产品性能？以及性能可实现的提升空间？**我们目前展开的下一代桌面芯片3B6600的研制，工艺不变，结构优化。硅前测试相比3A6000同频性能提高30%左右，预计单核性能处于世界领先行列，使用成熟工艺达到国外先进工艺CPU性能。当然最终龙芯的产品还是要到市场上去进行验证。**4、3B6600的研发时间表情况？**目前处于设计阶段，预计明年上半年交付流片，下半年样片回来。**5、公司服务器芯片产品要进入通用市场了吗？有哪些对标产品？以及公司服务器芯片的定价如何？**龙芯服务器芯片是通用芯片，因为属于龙芯增量市场，在市场开拓初期会有所侧重，比如在存储服务器市场领域重点突破。目前在售的服务器芯片产品主要为16核的3C5000和32核的3D5000。下一代服务器芯片3C6000系列处于样片阶段，产品化过程中，16核版本自测性能大致相当于至强4314，32核版本自测性能大致相当于至强6338，64核版本在封装估计年底前回来。预计2025年Q2完成3C6000系列产品化并正式发布。因为龙芯自主研发，成本上有优势，预计相比相同性能的市面产品，龙芯6000系列产品在价格上会有一定优势。 |